l环境温度过高。l 进风口不通畅。l 存在空槽位或间隔。l 传感器所在部件故障。不同服务器上“Inlet Temp”传感器所在部件不同,部件的位置也不尽相同,详细信息请参考服务器用户指南。下面以RH2288H V3服务器为例说明详细处理过程。RH2288H V3的“Inlet Temp”传感器位于左挂耳灯板上,左挂耳的位置请参考RH2288H V3产品用户指南。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 存在空槽位或间隔。l 传感器所在部件故障。不同服务器上“Inlet Temp”传感器所在部件不同,部件的位置也不尽相同,详细信息请参考服务器用户指南。下面以RH2288H V3服务器为例说明详细处理过程。RH2288H V3的“Inlet Temp”传感器位于左挂耳灯板上,左挂耳的位置请参考RH2288H V3产品用户指南。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 存在空槽位或间隔。l 传感器所在部件故障。不同服务器上“Inlet Temp”传感器所在部件不同,部件的位置也不尽相同,详细信息请参考服务器用户指南。下面以RH8100 V3服务器为例说明详细处理过程。下面以RH8100 V3的“Inlet Temp”传感器位于左挂耳灯板上,左挂耳的位置请参考RH8100 V3产品用户指南。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 灯板故障。

l环境温度过高。l 进风口不通畅。l 灯板故障。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 灯板故障。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 后IO框存在未安装假面板的PCIe卡空槽位。l 后IO板故障。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 后IO框存在未安装假面板的PCIe卡空槽位。l 后IO板故障。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 后IO框存在未安装假面板的PCIe卡空槽位。l 后IO板故障。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 前IO板故障。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 前IO板故障。

l 环境温度过高。l 进风口不通畅。l 前IO板故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 未正确安装导风罩。l 硬盘背板故障。

l风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 散热器接触不良。l 计算模块故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。lSSD卡故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l SSD硬盘对应的硬盘背板故障。l SSD硬盘故障。不同服务器上SSD硬盘对应的硬盘背板位置不同,详细信息请参考服务器用户指南。下面以RH2288H V3服务器为例说明详细处理过程。RH2288H V3服务器上,SSD硬盘对应的硬盘背板为前置硬盘背板,其位置请参考RH2288H V3服务器的用户指南。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l 散热器接触不良。l 主板故障。l CPU故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l 散热器接触不良。l 主板故障。l CPU故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l 主板故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l 后置硬盘背板故障。下面以RH2288H V3服务器为例说明详细处理过程。RH2288H V3的后置硬盘位置如图3-1所示。图 3-1 RH2288H V3 的后置硬盘背板位置

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l RAID卡故障

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l 内存故障。l 主板故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l 散热器接触不良。l 主板故障。l CPU故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l 散热器接触不良。l 主板故障。l CPU故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l 散热器接触不良。l 主板故障。l CPU故障。

l 环境温度过高。l 电源模块故障。

l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l电源模块故障。

l 风扇模块故障。l 业务量过大。l 环境温度过高。l 进风口堵塞。l 出风口堵塞。l 散热器接触不良l GPU卡故障。

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 未正确安装导风罩。l 板载网卡故障。

l 电源线缆未插稳或未连接。l 主板故障。

l电源线缆未插稳或未连接。l主板故障。

电源模块故障。

l 电源线缆未插稳或未连接。l 电源模块故障。

l 电源线未连接。l 电源供电电压不稳。l 电源模块故障。

l 电源模块被拔出。l 电源模块故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

HFC故障。

HFC故障。

HFC故障。

HFC故障。

l HFC故障。l 电源模块故障。

l HFC故障。l 电源模块故障。

主板故障。

主板故障。

l内存故障。l 主板故障。l CPU故障。

l 内存故障。l 主板故障。l CPU故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

主板故障。

l 告警产生在BIOS/POST阶段,为硬件异常,或BIOS启动异常。l 告警产生在OS Load阶段,为业务系统启动异常。l 告警产生在SMS/OS阶段,为业务软件异常。

l 告警产生在BIOS/POST阶段,为硬件异常,或BIOS启动异常。l 告警产生在OS Load阶段,为业务系统启动异常。l 告警产生在SMS/OS阶段,为业务软件异常。

l 告警产生在BIOS/POST阶段,为硬件异常,或BIOS启动异常。l 告警产生在OS Load阶段,为业务系统启动异常。l 告警产生在SMS/OS阶段,为业务软件异常。

l iBMC软件异常。l 传感器所在部件故障。不同服务器上“Inlet Temp”传感器所在部件不同,部件的位置也不尽相同,详细信息请参考服务器用户指南。下面以RH2288H V3服务器为例说明详细处理过程。RH2288H V3的“Inlet Temp”传感器位于左挂耳灯板上,左挂耳的位置请参考RH2288H V3产品用户指南。

l iBMC软件异常。l 主板故障。“PCH Temp”传感器位于服务器主板上,下面以RH2288H V3服务器为例说明详细处理过程。

l iBMC软件异常。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l CPU下属内存故障。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l 主板故障。

liBMC软件异常。l CPU下属内存故障。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l RAID卡故障。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l 风扇模块故障。l 主板故障。下面以RH2288H V3服务器为例说明详细处理过程。RH2288H V3服务器的风扇模块的位置如图3-2所示。图 3-2 RH2288H V3 的风扇模块位置

l iBMC软件异常。l 传感器所在部件与主板之间的线缆故障。l 传感器所在部件故障。l 主板故障。不同服务器上“RearDiskN Temp”传感器所在部件不同,部件所在位置也不尽相同,详细信息请参考服务器用户指南。下面以RH2288H V3服务器为例说明详细处理过程。RH2288H V3服务器的“RearDisk1 Temp”传感器位于后置硬盘背板1上,“RearDisk2Temp”传感器位于后置硬盘背板2上。两个后置硬盘背板的位置如图3-3所示。图 3-3 RH2288H V3 的后置硬盘背板位置

l iBMC软件异常。l SSD卡故障。l 主板故障。下面以RH2288H V3服务器配置的ES3000 V2为例说明详细处理过程。RH2288H V3服务器上ES3000 V2的安装位置如图3-4所示。图 3-4 RH2288H V3 的 SSD 卡位置

l iBMC软件异常。l 传感器所在部件与主板之间的线缆故障。l 传感器所在部件故障。l 主板故障。不同服务器上“SSD DiskN Temp”传感器所在部件不同,部件所在位置也不尽相同,详细信息请参考服务器用户指南。下面以RH2288H V3服务器为例说明详细处理过程。RH2288H V3服务器的“SSD DiskN Temp”传感器位于前置硬盘背板上,前置背板的位置请参考RH2288H V3服务器的用户指南。

l iBMC软件异常。l 板载网卡故障。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l 出风口传感器所在部件故障。

l iBMC软件异常。l 主板故障。

l iBMC软件异常。l 电源模块故障。l 主板故障。l 电源背板故障。

资产信息损坏。

硬盘/SD卡故障。

l RAID阵列的硬盘/SD卡被人为拔出。l RAID阵列的硬盘/SD卡故障。

SD卡故障。

l SD卡被移除。l SD卡未插稳。l SD卡控制器故障。

l 硬盘可用剩余空间低于阈值。l 硬盘模式为只读。l 硬盘内部错误过多。l 硬盘数据保护系统失效。

l 风扇模块不在位。l 风扇模块与主板接触不良。

l 风扇模块故障。l 风扇背板故障。

风扇模块故障。

电源模块风扇故障。

电源模块风扇故障。

l 内存故障。l 主板故障。

内存故障。

内存故障。

l 内存位置插错。l 内存故障。

l 内存位置插错l 内存故障

l 内存位置插错l 内存故障

l 风扇模块故障。l 环境温度过高。l 进风口/出风口堵塞。l 存在未安装假面板的硬盘空槽位。l 未正确安装导风罩。l 内存故障。

l BBU触发需要更换的告警l BBU Learn Cycle失败l BBU Learn Cycle超时l BBU触发预告警l BBU剩余容量过低(针对超级电容)l BBU没有空间用于Cache-offload

l CPU、内存、主板等硬件故障。l OS不兼容、逻辑状态异常等软件故障。

l CPU故障。l 主板故障。

l 受限的槽位上安装了需要I/O资源的PCIe卡。l 安装了服务器不支持的CPU。

l 在位的CPU类型不一致。l CPU故障。l 主板故障。

l CPU故障。l 主板故障。

l 内存镜像模式下,SMI2链路失效。l Jordan Creek内部发现错误。l 数据在Jordan Creek和内存控制器间传输时产生的错误达到门限值。

l QPI链路发生故障。l CPU故障。

l 未安装内存条。l 唯一的内存条因故障被BIOS隔离。l 唯一的内存条安装位置错误。

l PS/2或USB设备未接入。l PS/2或USB设备损坏。l 主板故障。

l显卡故障

单板上CPU混插,类型不匹配。

l CPU与BIOS版本不兼容。l CPU微码加载错误。

l SAS线缆连接错误。l SAS线缆故障。l SAS线缆连接的部件故障。

l 硬盘背板上的线缆连接异常。l 硬盘背板上的线缆故障。l 硬盘背板故障。

硬盘背板故障。

l RAID卡芯片故障。l RAID卡支持带外管理,但是通信故障。l RAID存在不可纠正错误。l RAID内存ECC错误达到阈值。l RAID卡NVRAM出现错误。

PCIe标卡存在错误。

不同类型的计算节点板混合使用。

不同类型的内存板混合使用。

不同类型的内存板混合使用。

l 系统正在运行的进程太多。l 某个进程占用CPU资源太多。

l 系统正在运行的进程太多。l 某个进程占用内存资源太多。

LCD串口线缆出现故障或者LCD被拔掉。

l 网络故障。l 管理板硬件故障。

l 硬盘背板与主板连接异常。l 硬盘背板故障。

l 硬盘背板与主板连接异常。l 硬盘背板故障。

l 硬盘背板与主板连接异常。l 硬盘背板故障。

l 前IO板故障l 硬盘背板故障

硬件故障。

PCIe设备故障。

PCH芯片故障。

l CPU数量不满足服务器当前要求。l CPU的安装位置不符合服务器的要求。

l 服务器安装了不兼容的CPU。l 服务器安装的多个CPU不是同一型号。

服务器单板插入的PBI型号不一致。

服务器计算模块和HFC板不匹配。

主板不支持NVME硬盘背板。